

证券代码：002916

证券简称：深南电路

### 深南电路股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-08

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他（_____）
参与单位名称及人员姓名（排名不分先后）	汇添富基金
时间	2024年3月21日
地点	机构投资者所在地（北京）
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：张丽君
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>交流主要内容：</b></p> <p><b>一、主要交流内容</b></p> <p><b>Q1、请介绍公司 PCB 业务 2023 年各主要下游领域经营拓展情况。</b></p> <p>2023 年，PCB 业务通信领域订单整体规模同比有所下降，主要由于国内通信市场需求未出现明显改善，海外市场下半年以来项目节奏有所放缓，导致相关需求后延。公司主动优化产品结构，结合一系列成本优化举措，降低通信市场需求弱化带来的影响。海外项目开发及产品导入工作取得进展，公司在海外客户处的订单份额保持稳定。</p> <p>PCB 业务数据中心领域报告期内订单整体同比微幅增长，主要由于在全球服务器市场 2023 年整体需求下滑的背景下，下半年以来公司部分客户 Eagle Stream 平台产品逐步起量，叠加在新客户及部分新产品（如 AI 加速卡等）开发上取得一定突破。</p> <p>PCB 业务汽车领域报告期内订单整体同比增长超 50%，主要得益于公司充分把握汽车电子在新能源和 ADAS 方向的增长机会，前期导入的新客户定点项目需求释放，以及 ADAS 相关高端产品的需求上量。南通三期工厂顺利爬坡为订单导入提供产能支撑。此外，海外 Tier 1 客户开发工作进展顺利，为未来汽车业务的持续发展奠定基础。</p> <p>此外，工控医疗、能源等其他领域 2023 年规模占 PCB 业务比重相对较小。公司将</p>

继续优化下游市场产品结构，增强市场拓展能力。

**Q2、请介绍当前 AI 领域的发展对公司 PCB 业务产生的影响。**

伴随 AI 的加速演进和应用上的不断深化，ICT 产业对于高算力和高速网络的需求日益紧迫，各类终端应用对边缘计算能力和数据高速交换与传输的需求迎来增长。上述趋势驱动了终端电子设备对高频高速、集成化、小型化、轻薄化、高散热等相关 PCB 产品需求的提升。公司 PCB 业务在高速通信网络、数据中心交换机、AI 加速卡、存储器等领域的 PCB 产品需求将受到上述趋势的影响。

**Q3、请介绍公司 PCB 业务汽车电子领域产品定位及主要客户类型。**

汽车电子是公司 PCB 业务重点拓展领域之一。公司以新能源和 ADAS 为主要聚焦方向，主要生产高频、HDI、刚挠、厚铜等产品，其中 ADAS 领域产品比重相对较高，应用于摄像头、雷达等设备，新能源领域产品主要集中于电池、电控层面。公司 PCB 业务汽车电子领域主要面向海外及国内 Tier1 客户，并参与整车厂部分研发项目合作。

**Q4、请介绍公司封装基板业务 2023 年在下游市场拓展情况。**

公司封装基板业务产品覆盖种类广泛多样，包括模组类封装基板、存储类封装基板、应用处理器芯片封装基板等，主要应用于移动智能终端、服务器/存储等领域。2023 年上半年全球半导体行业景气较弱，下游客户产品库存调整周期拉长，下半年以来部分领域需求有所修复。公司封装基板业务通过深耕存量市场、开发新客户等多措并举，保障业务营收的基本稳定。公司凭借广泛的 BT 类基板产品覆盖能力与针对性的销售策略把握需求回暖机遇，其中存储与射频产品受益于客户开发突破与下半年存量客户需求修复，均实现了订单同比增长。FC-BGA 封装基板部分产品已完成送样认证，处于产线验证导入阶段。

另一方面，无锡二期基板工厂持续推进能力提升与量产爬坡，加速客户认证和产品导入进程。广州封装基板项目一期建设推进顺利，已于 2023 年第四季度完成连线投产，目前已开始产能爬坡。无锡二期基板工厂爬坡和广州封装基板项目建设带来的成本和费用增加对公司报告期内利润造成一定负向影响。公司将继续推进封装基板业务战略目标客户开发与关键项目落地，推动无锡二期基板工厂实现盈利、加快 FC-BGA 产品线竞争

力建设，支撑广州封装基板项目顺利爬坡。

**Q5、请介绍公司封装基板业务在技术能力方面取得的突破。**

公司作为目前内资最大的封装基板供应商，具备包括 WB、FC 封装形式全覆盖的 BT 类封装基板量产能力，在部分细分市场拥有领先的竞争优势。2023 年，公司 FC-CSP 封装基板产品在 MSAP 和 ETS 工艺的样品能力已达到行业内领先水平，RF 封装基板产品成功导入部分高阶产品。

另一方面，针对 FC-BGA 封装基板产品，14 层及以下产品公司现已具备批量生产能力，14 层以上产品具备样品制造能力。公司在高阶领域新产品开发过程中仍将面临一系列技术研发挑战，后续将进一步加快技术能力突破和市场开发，同时也将继续引入该领域的技术专家人才，加强研发团队培养，提升巩固核心竞争力。

**Q6、请介绍公司电子装联业务 2023 年在下游市场拓展情况。**

公司电子装联产品按照产品形态可分为 PCBA 板级、功能性模块、整机产品/系统总装等，业务主要聚焦通信、数据中心、医疗电子、汽车电子等领域。2023 年，公司通过一站式解决方案平台，为客户提供持续增值服务，增强客户粘性，并持续加强内部运营及供应链管理，在营收和毛利率层面均实现提升。公司将继续以数据中心、汽车等市场领域为重点，并持续深耕通信、工控、医疗等领域。

**Q7、请介绍公司近期工厂稼动率变化情况。**

近期公司 PCB 及封装基板业务稼动率较 2023 年第四季度均有所提升。

**Q8、请介绍公司研发投入同比增长的原因。**

报告期内，公司研发投入 10.73 亿元，金额同比增长 30.94%，占营收比重为 7.93%，占比同比提升 2.07 个百分点。研发投入增长主要受 FC-BGA 封装基板平台能力建设等项目影响。

注：调研过程中公司严格遵照《信息披露管理制度》等规定，未出现未公开重大信息泄露等情况。

附件清单	无
日期	2024年3月21日